

## 2009年3月期第2四半期決算説明会資料

～ライフサイエンスの好調により08年度2Q累計営業利益は増額修正、126億円を計上～

2008/10/23

 株式会社日立ハイテクノロジーズ

執行役社長 大林 秀仁

## 2009年3月期第2四半期 決算説明会

2009年3月期第2四半期累計期間 決算概要

2009年3月期 業績予想概要

参考: データ集

## 2009年3月期第2四半期累計期間 決算概要

(注)YY/MはYY年M月期を表しています。

# 2009年3月期第2四半期累計期間(ハイライト)



(億円)

	(新基準) 前回予想 (e)	業績偏差 (x)	(新基準) 実績 (e1)=(e+x)	対前回予想 増減率	会計方針 変更影響額(y)	(旧基準) 実績 (e1+y)	前年同期比
売上高	4,150	+ 84	4,234	+ 2%	237	4,471	8%
営業利益	88	+ 38	126	+ 43%	50	176	25%
経常利益	93	+ 46	139	+ 50%	50	189	20%
当期純利益	43	+ 33	76	+ 76%	—	—	—

(注) 第1四半期連結会計期間より、半導体製造装置、液晶関連製造装置等、出荷後に据付作業を要する製品の収益認識基準を出荷基準から据付完了基準に変更しております。

(注) (e)は、新基準前回予想(2008年7月公表値)  
(e1)は、新基準今回予想(2008年10月公表値)

# 2009年3月期第2四半期累計期間(偏差説明)

対前回予想値(2008年7月1Q決算発表時)比較

## 1.偏差説明

売上高 ( 4,150億円 4,234億円 + 84億円)

- 電子デバイスシステム:半導体製造装置の需要減等により12億円減
- ライフサイエンス:欧米向け医用分析装置の好調等により31億円増
- 先端産業部材:液晶関連部材の販売増等により65億円増

営業利益 ( 88億円 126億円 + 38億円)

- 電子デバイスシステム:コスト低減等により13億円増
- ライフサイエンス:欧米向け医用分析装置の好調等により19億円増

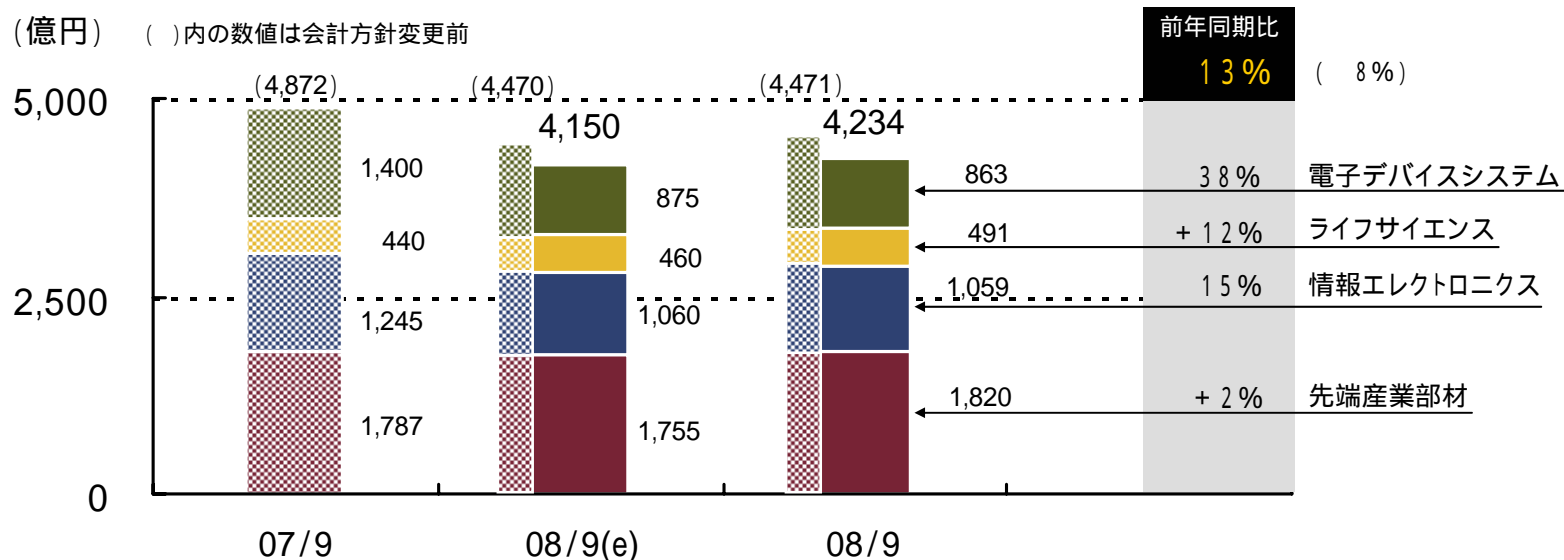
## 2.収益認識基準変更による影響

(億円)

	前回予想	実績	偏差
売上高	320	237	+ 83
営業利益	67	50	+ 17

# 2009年3月期第2四半期累計期間実績(売上高)

## 売上高



(億円)

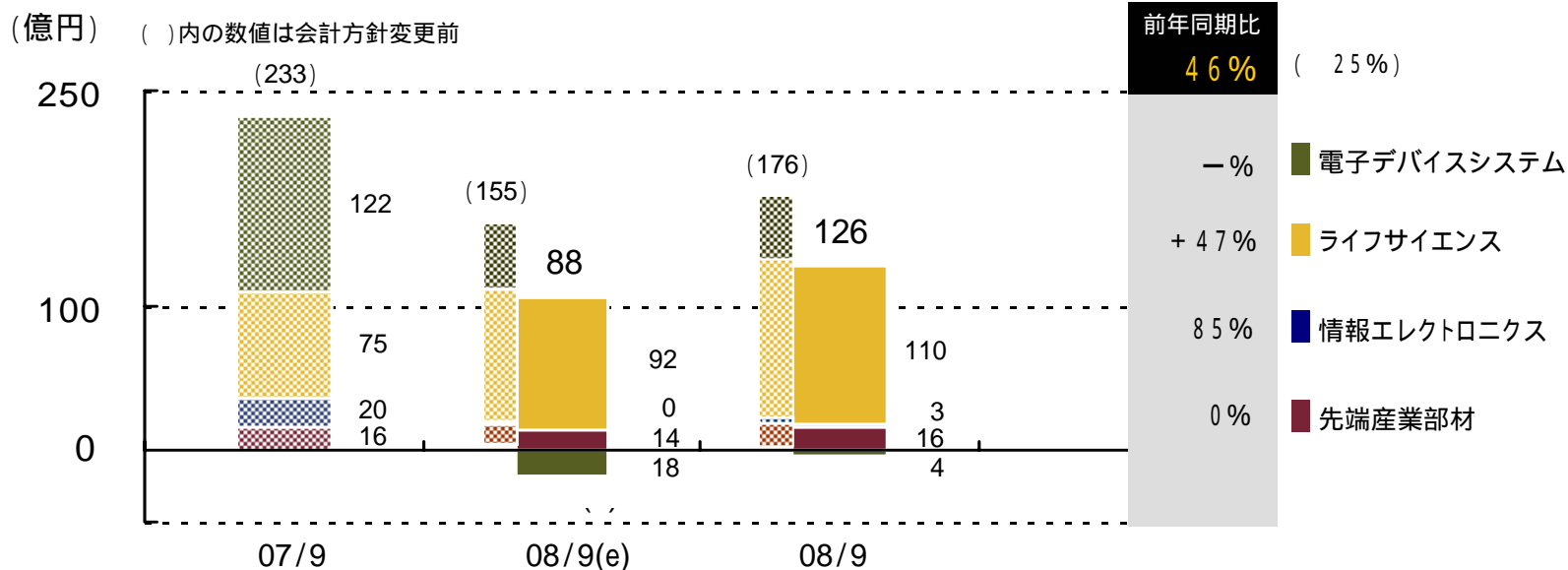
	07/9 実績	業績変動 影響額	08/9旧基準 実績	旧基準 前年同期比	会計方針変更 影響額
電子デバイスシステム	1,400	309	1,092	22%	229
情報エレクトロニクス	1,245	178	1,067	14%	8

## 前年同期比 増減説明 (旧基準)

- 電子デバイスシステム: 半導体製造装置、液晶関連製造装置(商事品)、HD関連製造装置の需要減等により減少
- ライフサイエンス: 欧米向け医用分析装置の貢献等で増加
- 情報エレクトロニクス: チップマウンタ、アジア向け半導体デバイスの販売減等により減少

# 2009年3月期第2四半期累計期間実績(営業利益)

## 営業利益



	07/9 実績	業績変動 影響額	08/9旧基準 実績	旧基準 前年同期比	会計方針変更 影響額
電子デバイスシステム	122	77	45	63%	49
情報エレクトロニクス	20	16	4	80%	1

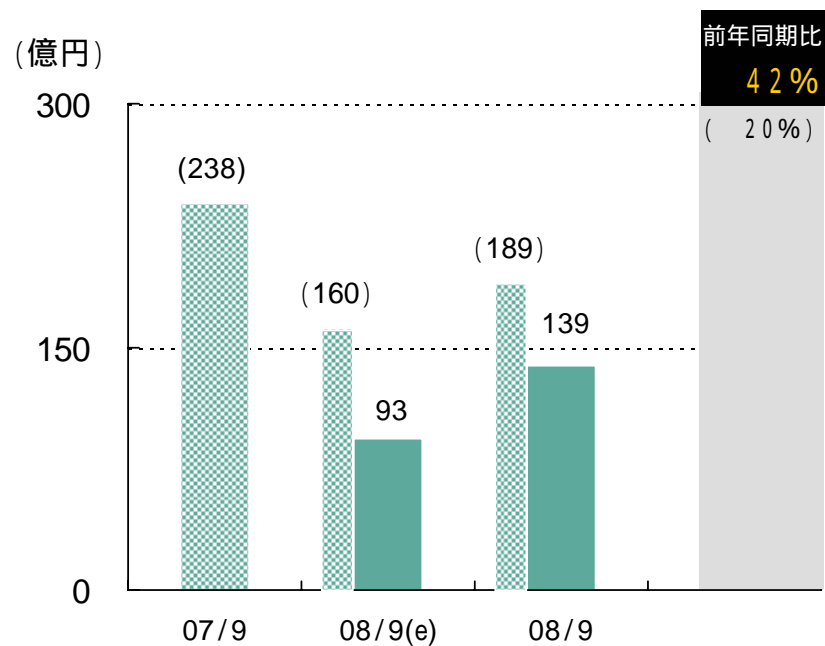
## 前年同期比 増減説明 (旧基準)

- 電子デバイスシステム: 半導体製造装置、HD関連製造装置の需要減等により減少
- ライフサイエンス: 欧米向け医用分析装置の好調持続等により増加
- 情報エレクトロニクス: チップマウンタの販売減等により減少

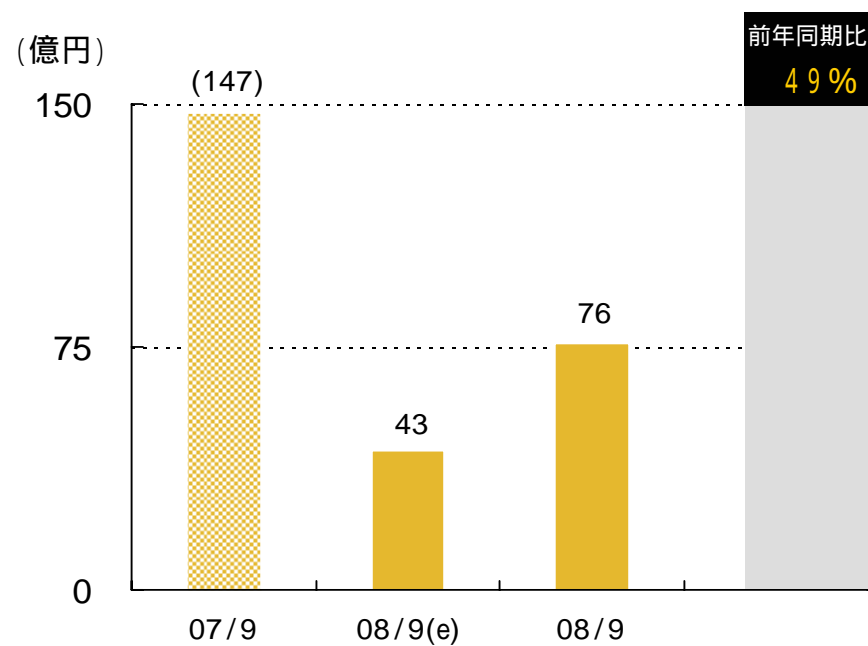
# 2009年3月期第2四半期累計期間 (経常利益・当期純利益)



## 経常利益



## 当期純利益



( )内の数値は会計方針変更前

## 前年同期比 増減説明 (旧基準)

- 営業外損益は改善するも、営業利益の減少により経常利益は減少
- 経常利益の減少等により当期純利益も減少



# 財政状態(貸借対照表(要約))

2008年9月末 (億円)

		08/3末比				08/3末比	
<b>流動資産</b>		3,896	220	<b>流動負債</b>		2,145	283
現預金、関係会社預け金	660	58	支払手形及び買掛金		1,494	287	
受取手形及び売掛金	2,151	323	その他		651	+5	
たな卸資産	819	+148	<b>固定負債</b>		270	+0	
その他	267	+13	退職給付引当金		260	+2	
<b>固定資産</b>		917	16	その他		10	2
有形固定資産	594	+7	<b>純資産</b>		2,398	+47	
無形固定資産	42	+3	株主資本		2,374	+52	
投資その他の資産	281	26	評価・換算差額等		22	5	
			少数株主持分		2	+0	
<b>資産合計</b>		4,813	236	<b>負債及び純資産合計</b>		4,813	236

## ポイント説明

- 自己資本比率: 49.8% (08/3末比 + 3.3%)
- 一株当たり純資産: 1,741円90銭 (08/3末比 + 34円21銭)

# 財政状態(キャッシュ・フロー計算書〔要約〕)

(億円)	08/1H		08/1H
営業活動による キャッシュ・フロー	+ 3	財務活動による キャッシュ・フロー	75
税引前利益	+ 141	配当金の支払	24
減価償却費	+ 43	少数株主からの株式買取	(注2) 51
正味運転資金	128	その他	0
法人税等支払	91	現金及び現金同等物の 四半期残高	+ 687
その他	+ 38	増減額	92
投資活動による キャッシュ・フロー	20	期首残高	+ 779
有価証券の取得・売却	+ 28		
固定資産取得・売却	(注1) 48		
その他	+ 0		
フリー・キャッシュ・フロー	16		

ポイント説明	
(注1)	日立ハイテクインスツルメンツ新社屋建設 23億円他
(注2)	米国子会社の自己株式取得 51億円

## 2009年3月期 業績予想概要

(注)YY/MはYY年M月期を表しています。

# 2009年3月期業績予想(ハイライト)

(億円)

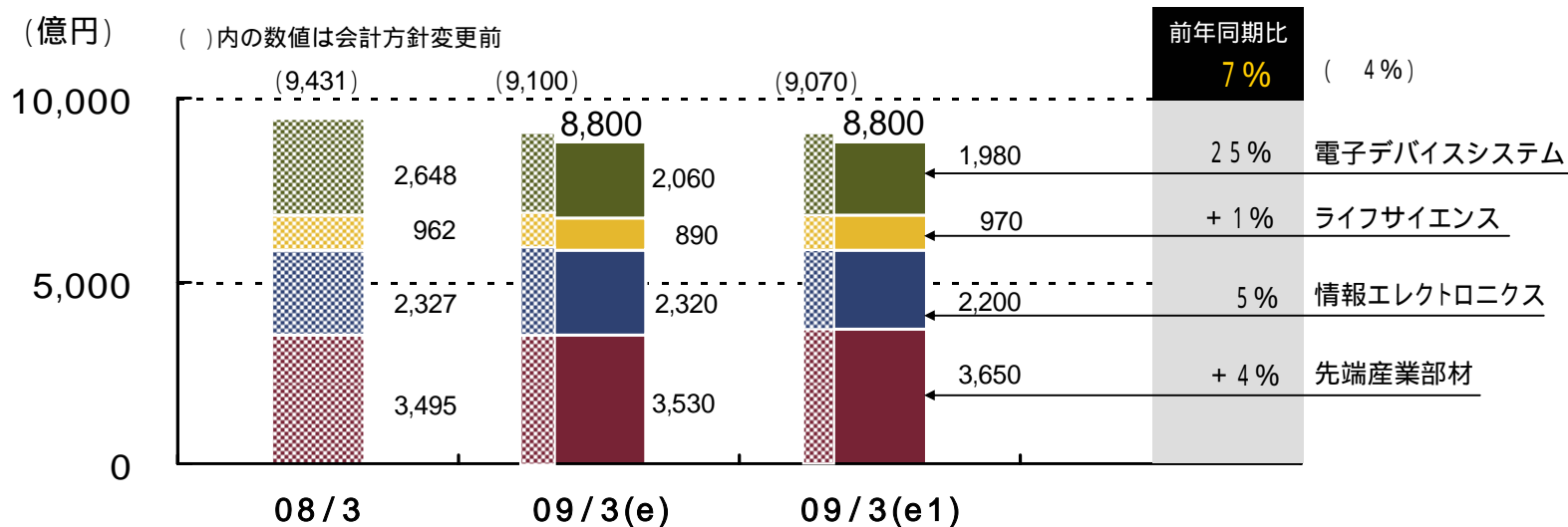
	(新基準) 前回予想 (e)	業績偏差 (x)	(新基準) 今回予想 (e1)=(e+x)	対前回予想 増減率	会計方針 変更影響額(y)	(旧基準) 今回予想 (e1+y)	対前期比
売上高	8,800	0	8,800	0%	270	9,070	4%
営業利益	350	0	350	0%	68	418	15%
経常利益	353	0	353	0%	68	421	14%
当期純利益	220	0	220	0%	—	—	—
ROE	—	—	9%	—	—	—	—
FIV	—	—	90	—	—	—	—

(注) 想定レート: 1USD = 102円  
1EUR = 155円

(注) (e)は、新基準前回予想(2008年7月公表値)  
(e1)は、新基準今回予想(2008年10月公表値)

# 2009年3月期業績予想(売上高)

## 売上高



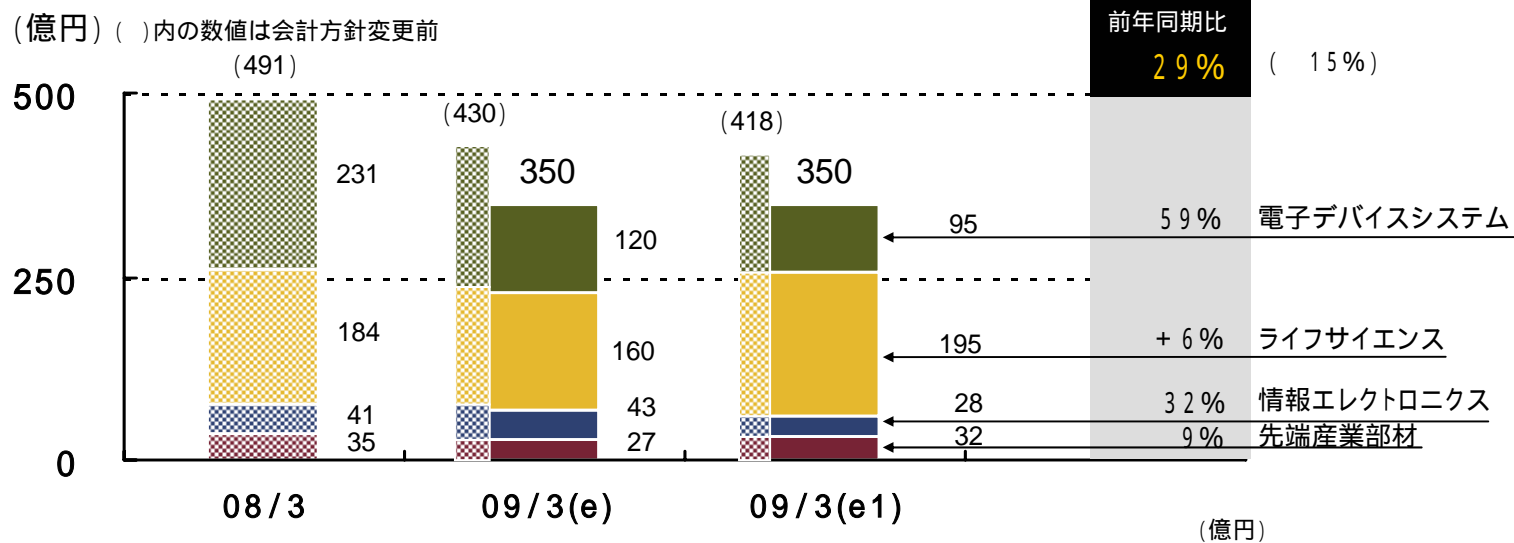
	08/3 実績	業績変動 影響額	09/3(e1) 旧基準	旧基準 前年同期比	会計方針変更 影響額
電子デバイスシステム	2,648	418	2,230	16%	250
ライフサイエンス	962	+11	973	+1%	3
情報エレクトロニクス	2,327	110	2,217	5%	17

## 前年同期比 増減説明 (旧基準)

- 電子デバイスシステム: 半導体製造装置・HD関連製造装置の投資抑制継続等により減少
- 情報エレクトロニクス: 半導体デバイスおよび液晶等メディアデバイスの需要減等により減少

# 2009年3月期業績予想(営業利益)

## 営業利益



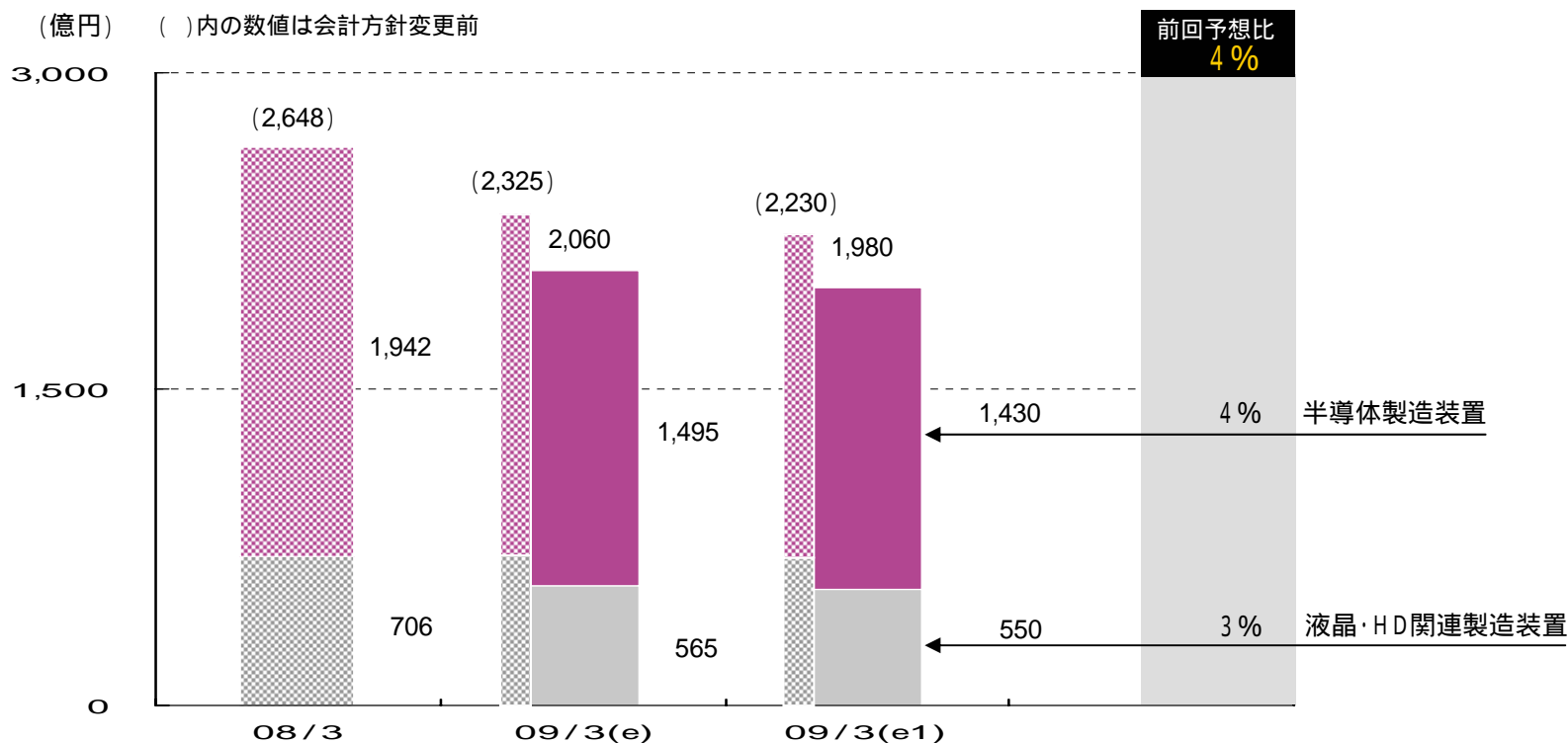
	08/3 実績	業績変動 影響額	09/3(e1) 旧基準	旧基準 前年同期比	会計方針変更 影響額
電子デバイスシステム	231	71	160	31%	65
ライフサイエンス	184	+11	196	+6%	1
情報エレクトロニクス	41	11	30	27%	2

## 前年同期比 増減説明 (旧基準)

- 電子デバイスシステム: 半導体製造装置・HD関連製造装置の投資抑制継続等により減少
- 情報エレクトロニクス: 半導体デバイスおよび液晶等メディアデバイスの需要減等により減少
- 先端産業部材: 営業開発投資増加等により減少

# セグメント別業績予想(電子デバイスシステム)

## 売上高

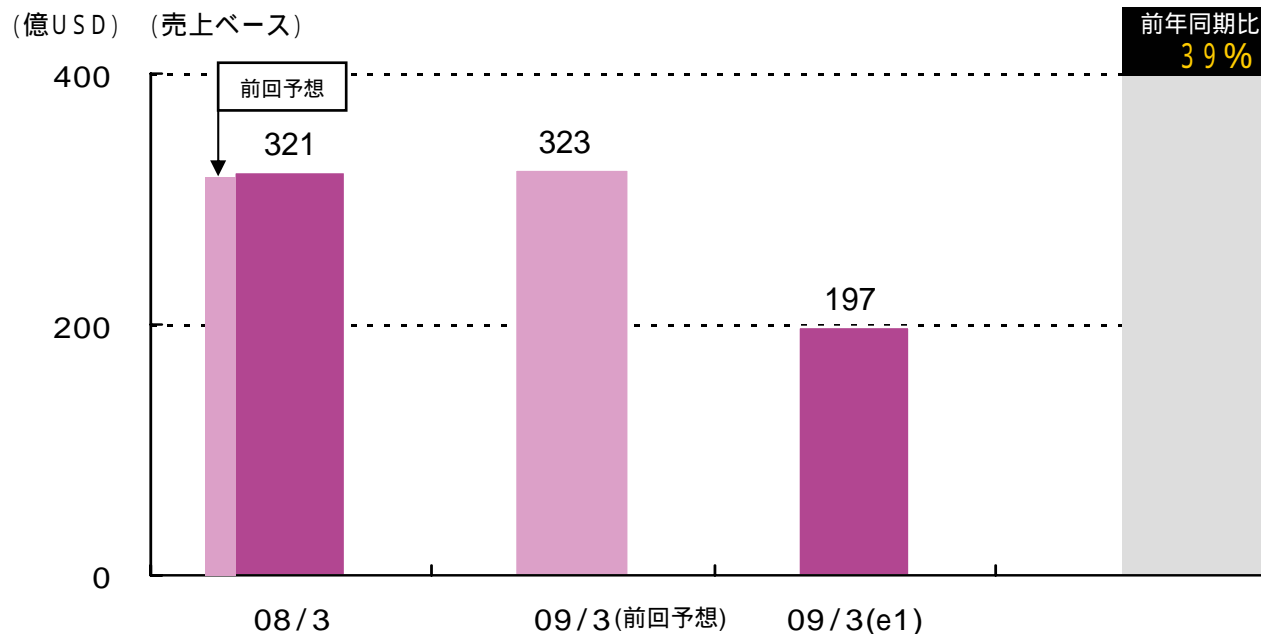


### 会計方針変更による影響額

	前回予想(e)	今回予想(e1)	偏差
半導体製造装置	120	100	+20
液晶・HD関連製造装置	145	150	5

# 市場動向(半導体製造装置)

## 半導体製造装置(前工程)市場



(出所) 08年6月迄のSEMI実績値及び当社推測  
前回予想は2008年4月の決算発表時の見通し

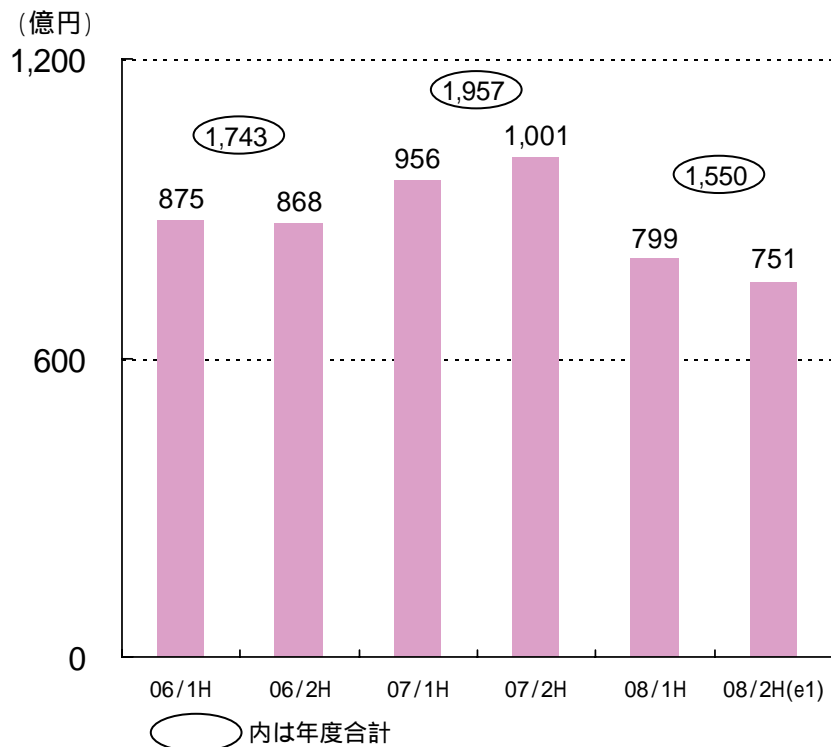
## 状況説明

- ・08年度前半は、原油価格の高騰等マクロ経済の不透明感に加え、5月の中国四川大地震やオリンピックイヤー特需が期待を裏切る結果となり、メモリーメーカー向けを中心に半導体製造装置市場は低調に推移
- ・08年度後半も米国金融危機に端を発した世界的なリセッション懸念により、半導体が搭載される最終製品の売上減少から、メモリーを始めとした半導体需要の減少や価格下落圧力が強まる可能性が高く、08年度通年でも大幅なマイナス成長を予想

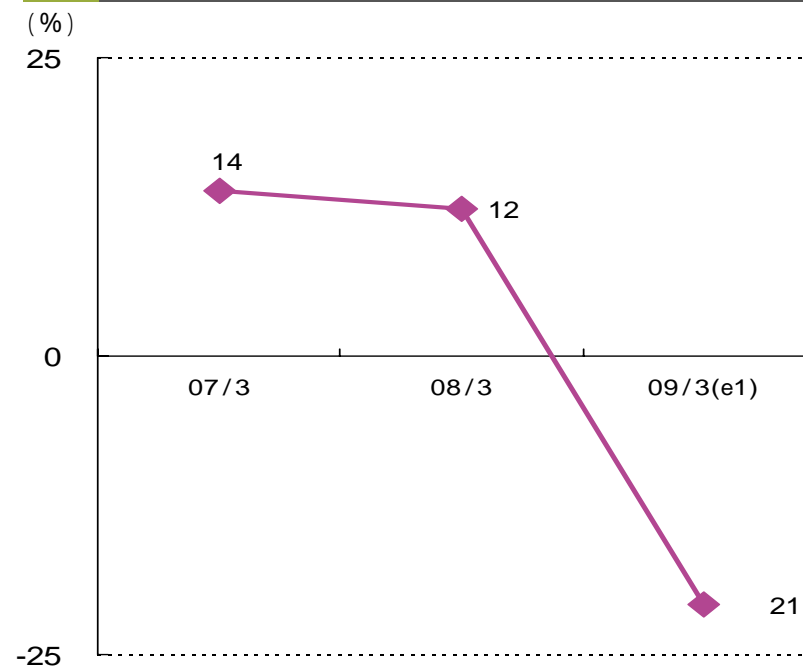


# 受注高の推移 (半導体製造装置)

連結受注高の推移



連結受注高の推移 (前年同期比伸び率)

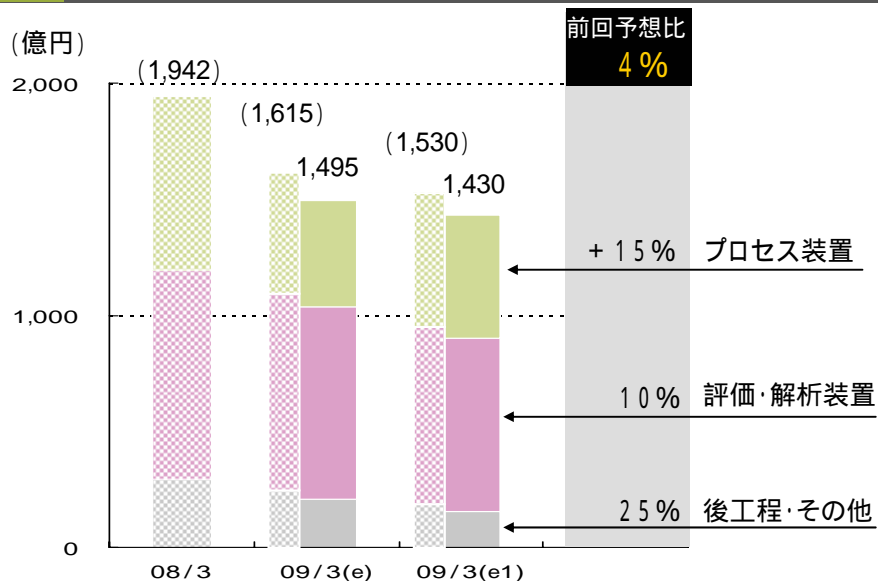


## 状況説明

- ・08 / 1H: 国内外顧客の投資抑制により、自社品、商事品とも受注環境は厳しく、前年同期比 16%
- ・08 / 2H: メモリーメーカーを中心に顧客投資抑制が続くため、前年同期比 25%を予想
- ・08年度: 上記により、前年同期比 21%を予想

# 売上高の推移 (半導体製造装置)

## 主要製品群別売上高の推移

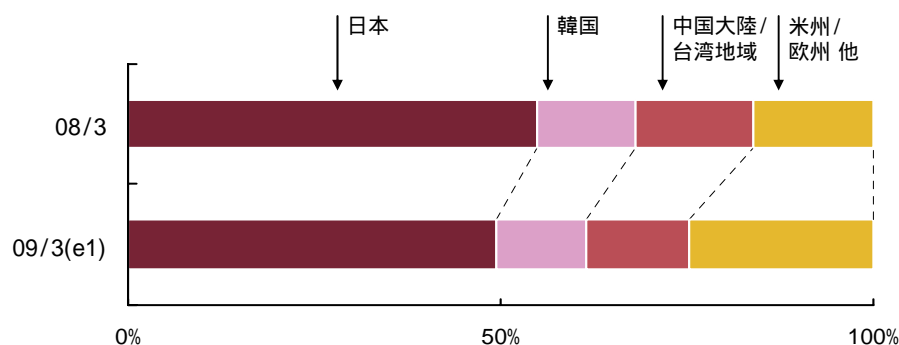


( )内の数値は会計方針変更前

## 偏差説明

- プロセス装置
  - ・エッチング装置は、国内顧客の投資抑制等を海外大手顧客の投資再開によりカバーし、増加
- 評価・解析装置
  - ・評価装置：国内・アジアのデバイスメーカーの投資抑制により、大幅減
  - ・解析装置：景気後退により半導体分野以外も厳しい状況にあるが、新製品投入等によりほぼ前回計画通り
- 後工程装置(ダイボンダ)
  - ・DRAM、NAND Flash用とも韓国中心とした市況悪化の影響により減

## 地域別売上高比率

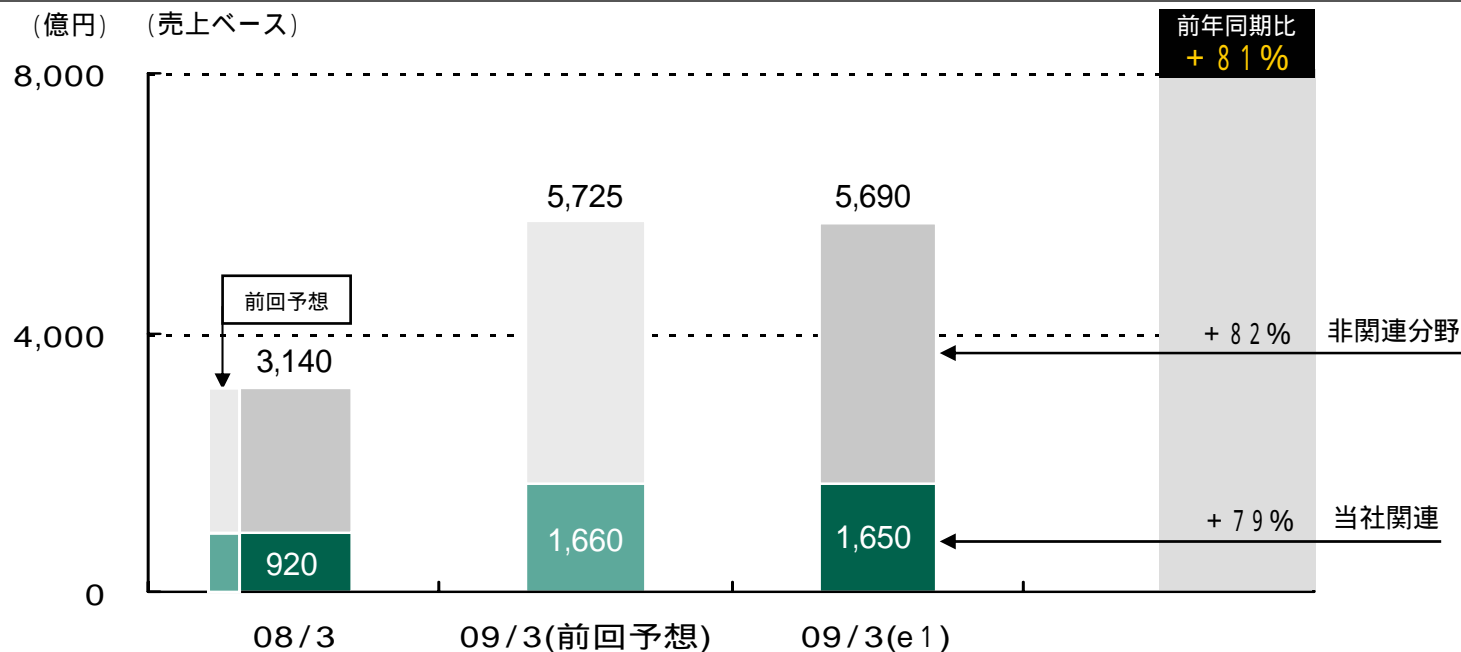


## 今後の取り組み

- プロセス装置
  - ・米国大手顧客からのエッチング装置継続受注及び国内外顧客への部品サービス事業の拡大
- 評価・解析装置
  - ・評価装置：比較的堅調なMPU、ロジックメーカーへの拡販及び韓国、台湾市場での地盤固め
  - ・解析装置：国内外の大学、研究機関への販売促進 (日本：補正予算の取り組み)
- 後工程装置(ダイボンダ)
  - ・新製品の投入によるメモリー以外からの引合取り込み

# 市場動向(液晶関連製造装置)

## 液晶関連製造装置市場



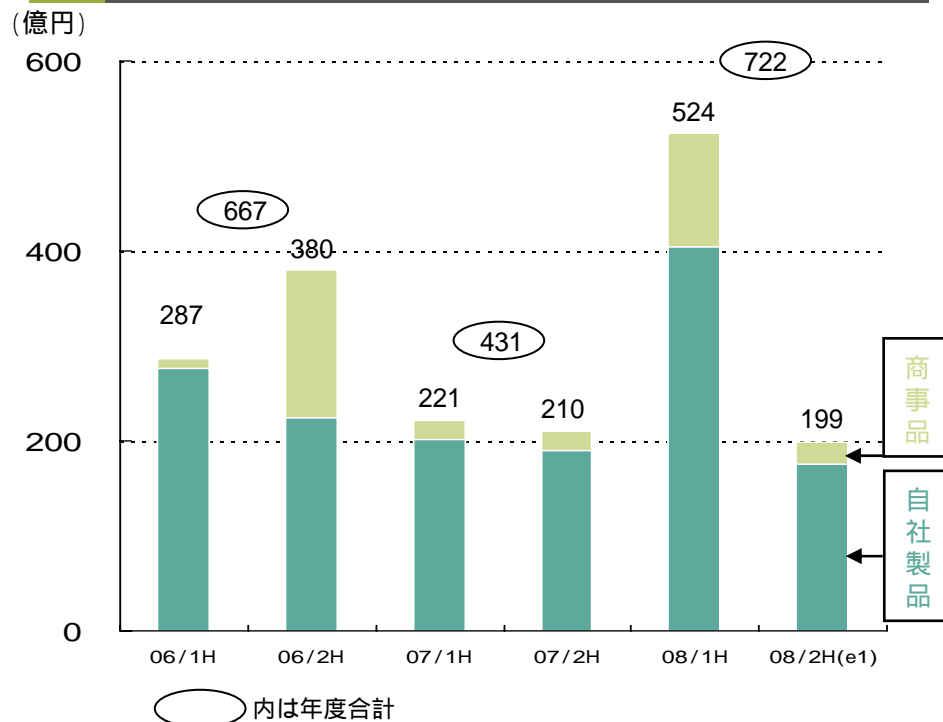
(出所)SEAJ(08年7月)データに基づき当社にて推測  
 前回予想は2008年4月決算発表時の見通し

## 状況説明

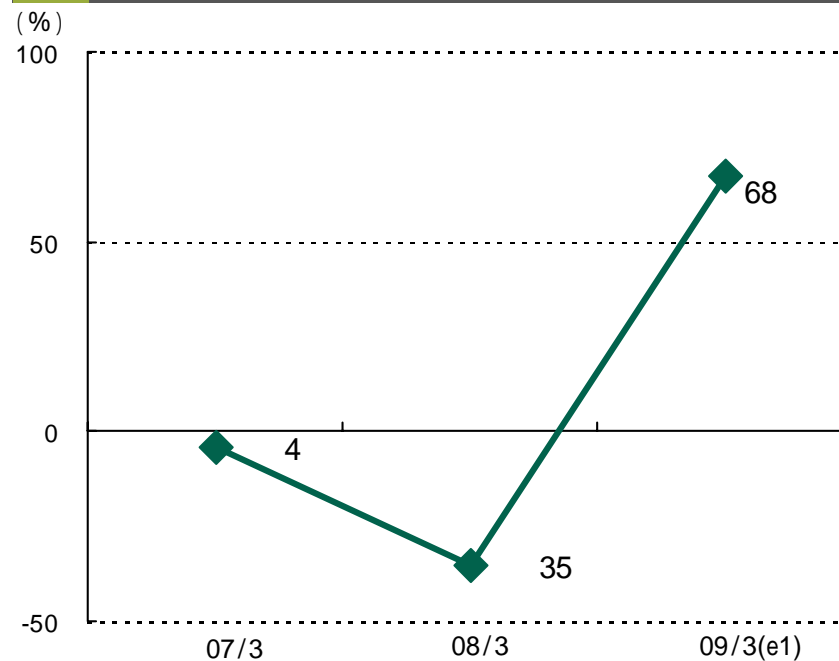
- ・08年度の製造装置市場は前年同期比+81%を見込むが、6月からの急激な市況の変化により縮小方向
- \*08年当初は、需要が供給を上回るとの予測でセットメーカーがパネルを前倒し発注、パネル価格も上昇
- \*大型TVやモニターを中心に想定より需要が伸びず、6月以降需給バランスが崩れパネル価格が大幅に下落、台湾メーカーを中心に減産を継続中
- \*08年度後半も世界的な景気低迷の影響も重なり回復が遅れるとの見方が強い

# 受注高の推移 (液晶関連製造装置)

連結受注高の推移



連結受注高の推移 (前年同期比伸び率)

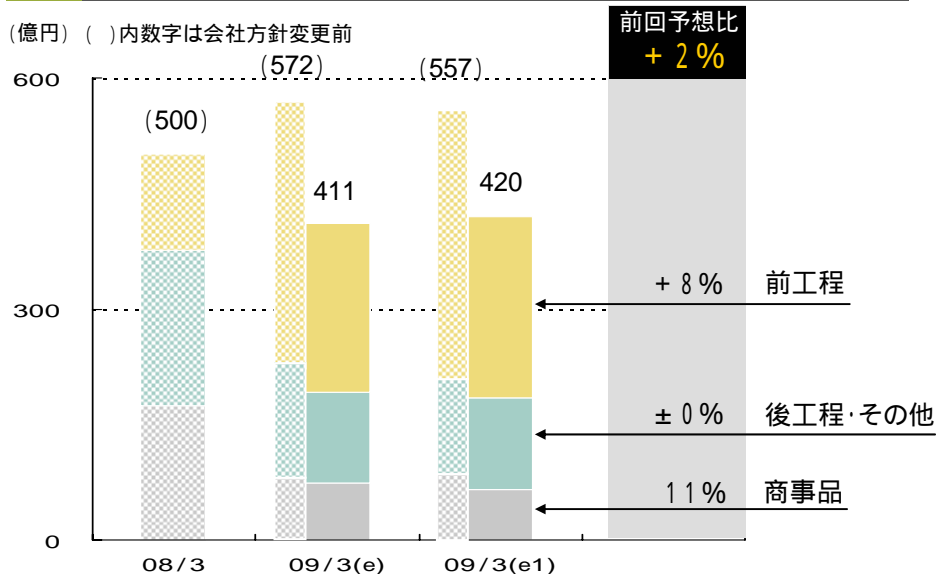


## 状況説明

- ・08 / 1H: 実装装置は投資サイクルの影響で減少するが、前工程の投資集中による露光装置と商事品の大幅受注増で、前年同期比 + 137%
- ・08 / 2H: 液晶市場の需給バランスの崩れから6月以降急激にパネル価格が下落  
顧客の慎重な投資スタンスにより前年同期比 - 5%を予測
- ・08年度: 上記により前年同期比 + 68%と予測

# 売上高の推移 (液晶関連製造装置)

## 主要製品群別売上高の推移



## 偏差説明

前工程を中心に堅調に推移する見込みだが市況悪化が懸念材料

### 前工程

投資の中心はG8以上に移行、売上比率は67%に達する見込み

- ・露光装置は、投資回復で増加を見込む
- ・ウェットプロセス装置は、G10対応装置等高付加価値製品にシフト

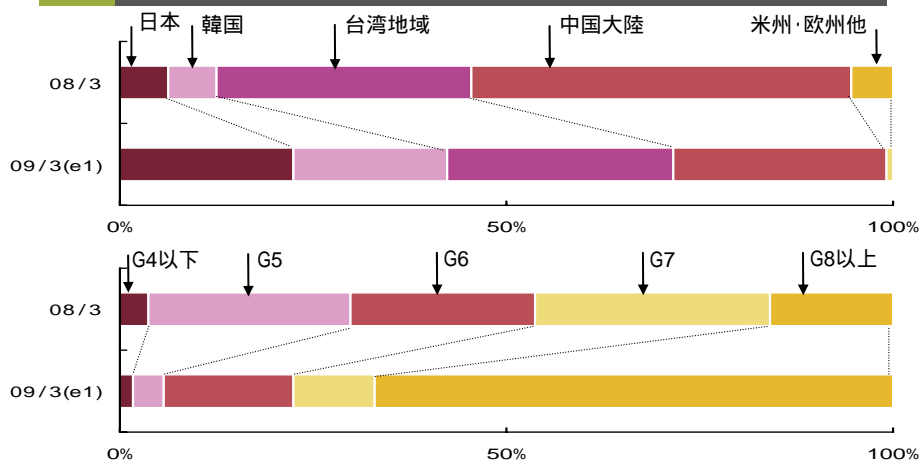
### 後工程・その他

・実装装置は、投資一巡により低調

### 商用品

・一部製品の検収時期のスライド

## 地域別・世代別 (前工程装置) 売上高比率



## 今後の取り組み

### 前工程

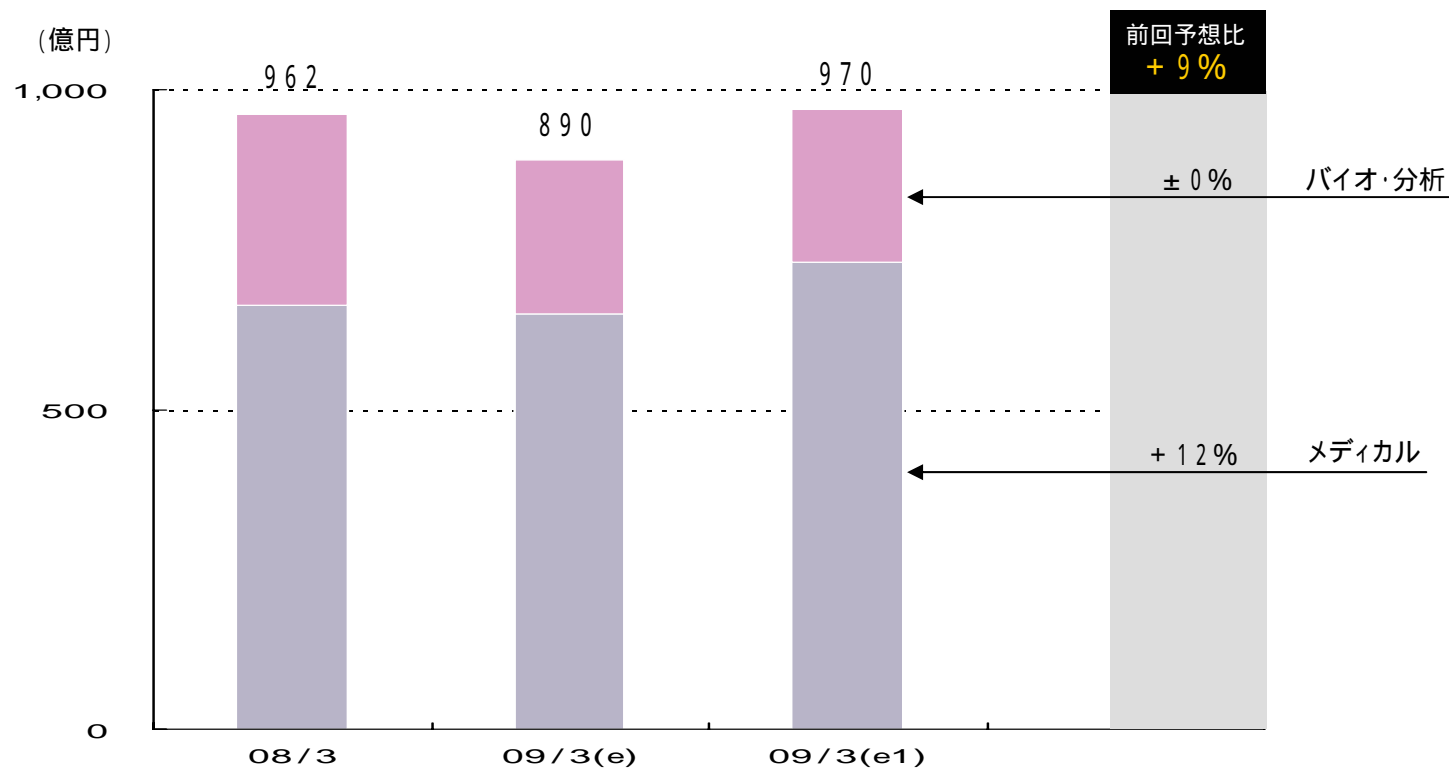
・G10対応装置は08年度3Qに出荷開始

### 後工程・その他

・高生産性装置 (新製品) を開発中

# セグメント別業績予想(ライフサイエンス)

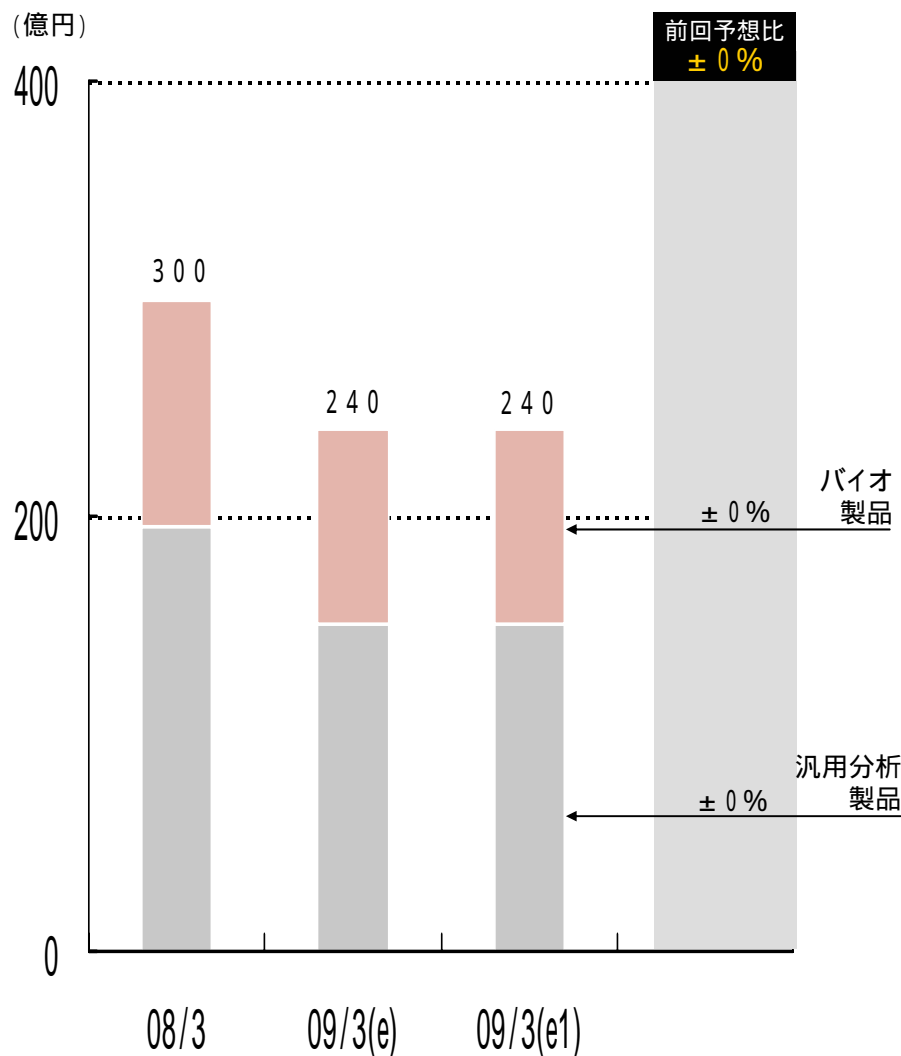
## 売上高



(注)当セグメントの会計方針変更による影響額は  
僅少のため、記載を省略しております。

# 売上高の推移 (バイオ・分析)

## 売上高の推移



## 偏差説明

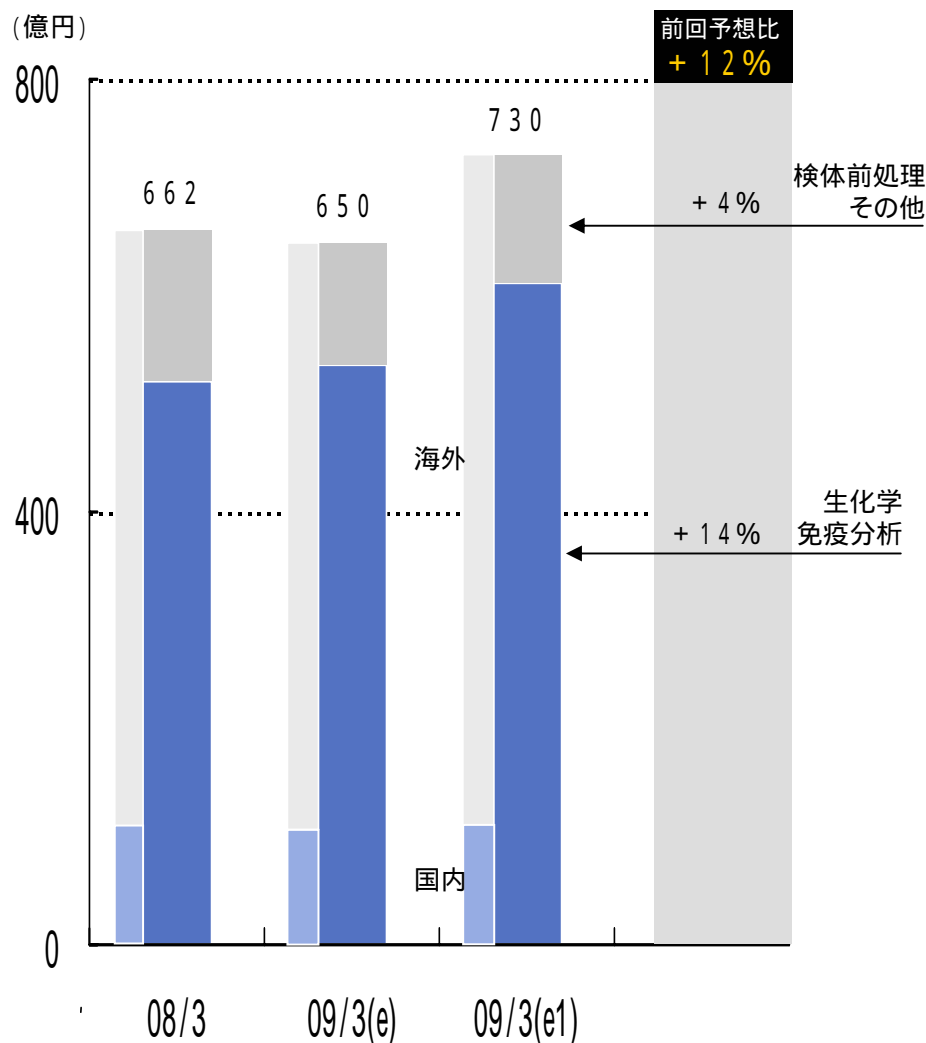
- ・商事品の選択と集中が、07年度で終了  
08年度は、前回予想通り推移

## 今後の取り組み

- バイオ製品
  - ・DNAシーケンサは、遺伝子鑑定・診断向けのアプリケーションの充実により伸長が期待される応用市場へ拡販
  - ・液体クロマトグラフ質量分析装置は、新製品のECD(電子捕獲解離)技術搭載機により、タンパク質解析機能向上とバイオマーカー探索市場へ展開
- 汎用分析製品
  - ・液体クロマトグラフ  
業界標準のデータステーションとの接続により最大マーケットの製薬分野へ深耕
  - ・光度計  
アプリケーション強化による食品・環境分野への展開
  - ・商事品  
専任営業部隊の新設により販売を強化

# 売上高の推移 (メディカル)

## 売上高の推移



## 偏差説明

- ・欧州向けの新型中規模生化学・免疫分析システム、新型小形免疫分析装置等の販売好調により増加

## 今後の取り組み

- 生化学・免疫分析
  - ・欧州向けは、ロシュ社とのSCBの深耕と拡販支援の継続により、市場の成長率を上回る伸長を目指す
  - ・国内及び中国では、試薬メーカーとの協力推進やオンラインサポートサービス導入に伴う新たな付加価値の提供により、需要を喚起
- 検体前処理システム
  - ・分析装置と前処理両方を製造する唯一のメーカーとして、前処理システムと各種分析装置を接続し、検体受付処理から結果報告までの一連ワークフローの自動化を実現
- 新規事業
  - ・仏バイオメリュー社と細菌検査事業・遺伝子検査事業でのSCBを推進

\* SCB : System Collaboration Business



## 検査室の効率化・安全に貢献する「検体検査自動化システム」

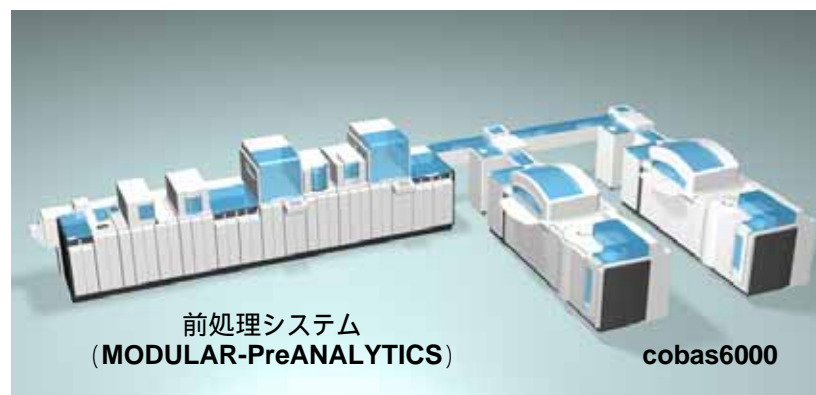
モジュールアセンブリ方式により、  
検査室の規模や要求に応じてフレキシブルなシステム構築を実現

### 検体検査自動化システムの特徴

- 効率的なラック搬送を実現する非同期分散システム
- メンテナンスフリーのシリンジレス分注システム
- 検体ラックの追い越しを可能とするラック引き込み方式

### システム構成例

- 前処理システムと各種分析装置を接続し、検体受付処理から結果報告までの一連ワークフローの自動化を実現
- 煩雑な検査業務の省力化・効率化に貢献



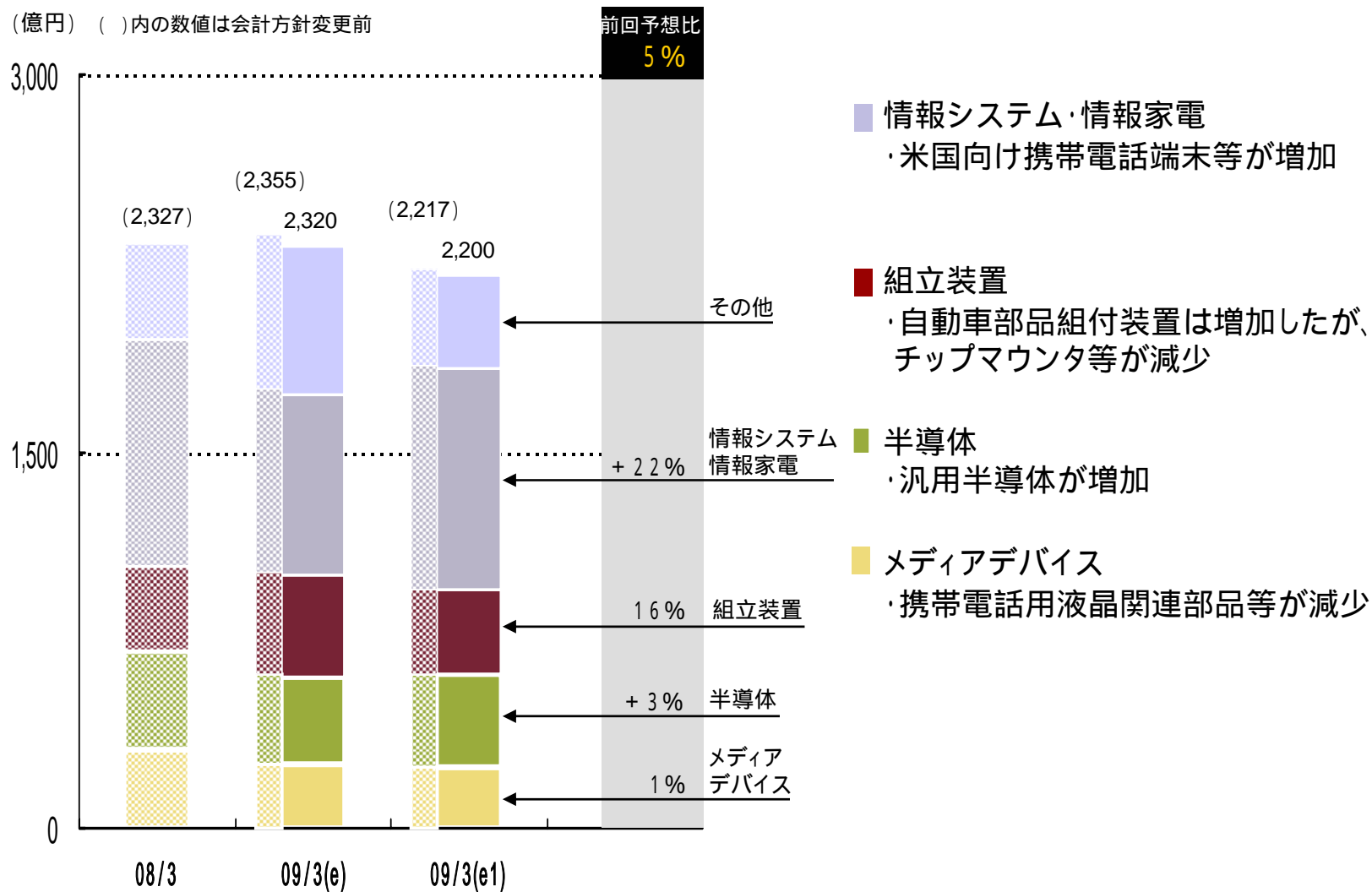
cobas6000 システム構成の例 (2台接続)

# セグメント別業績予想 (情報エレクトロニクス)

## 売上高の推移

## 前回予想比増減説明

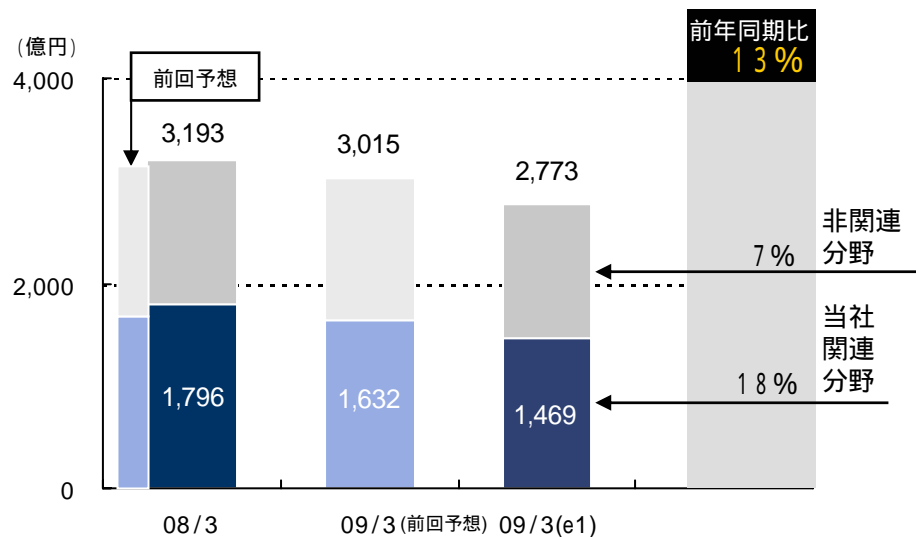
(億円) ( )内の数値は会計方針変更前



- 情報システム・情報家電
  - ・米国向け携帯電話端末等が増加
- 組立装置
  - ・自動車部品組付装置は増加したが、チップマウンタ等が減少
- 半導体
  - ・汎用半導体が増加
- メディアデバイス
  - ・携帯電話用液晶関連部品等が減少

# 市場動向及び売上高の推移(チップマウンタ)

## チップマウンタ市場

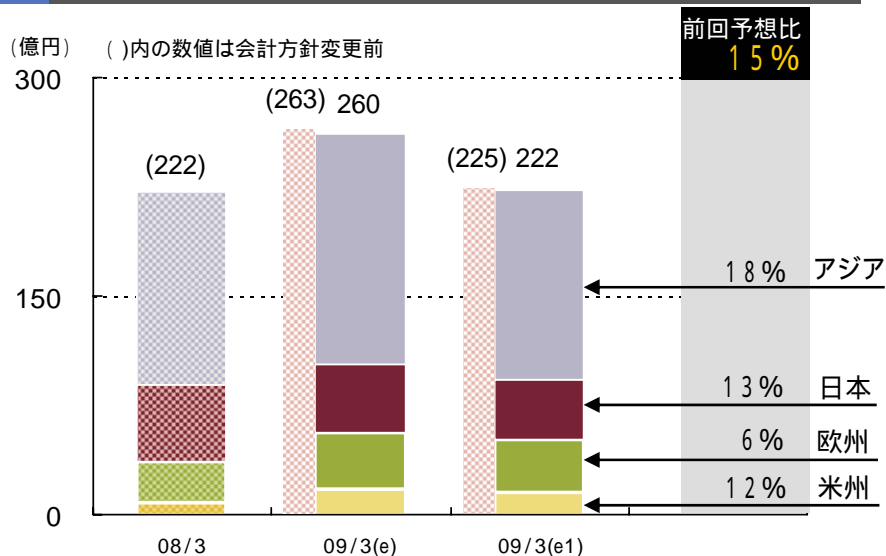


## 状況説明(当社関連市場)

- ・08年度前半は、携帯電話・ノート型PC・薄型TV等エレクトロニクス市場の設備投資需要は弱含みで推移。EMSの設備投資も様子見の状況
- ・08年度後半から09年度も世界的景気後退により大きな設備投資は期待できず、08年度通年でも、市場規模は縮減

(出所) 日本ロボット工業会資料(07年11月)調査機関資料に基づき当社作成  
 前回予想は2008年4月の決算発表時の見通し

## 売上高の推移



## 偏差説明と今後の取り組み

- ・ユーザーの設備投資減少・凍結により競争が激化するも、前年度比では横ばいを維持

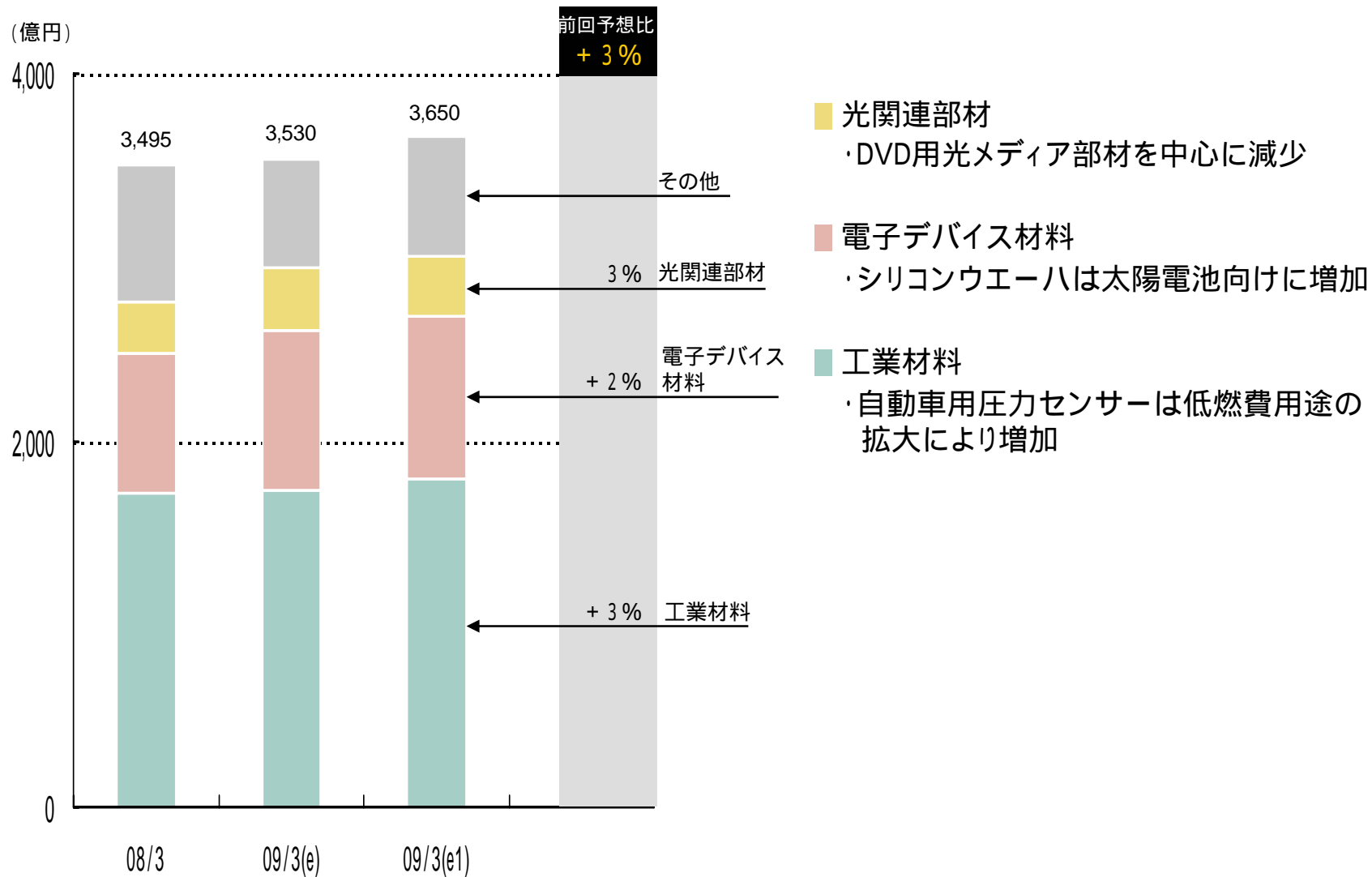
### 【今後の取り組み】

- ・高密度実装・実効生産性能の訴求によるシェア拡大
- ・アジアを中心としたグローバル営業力・サービス力強化の継続
- ・新工場活用による高品質・効率的生産の推進と製品開発の強化

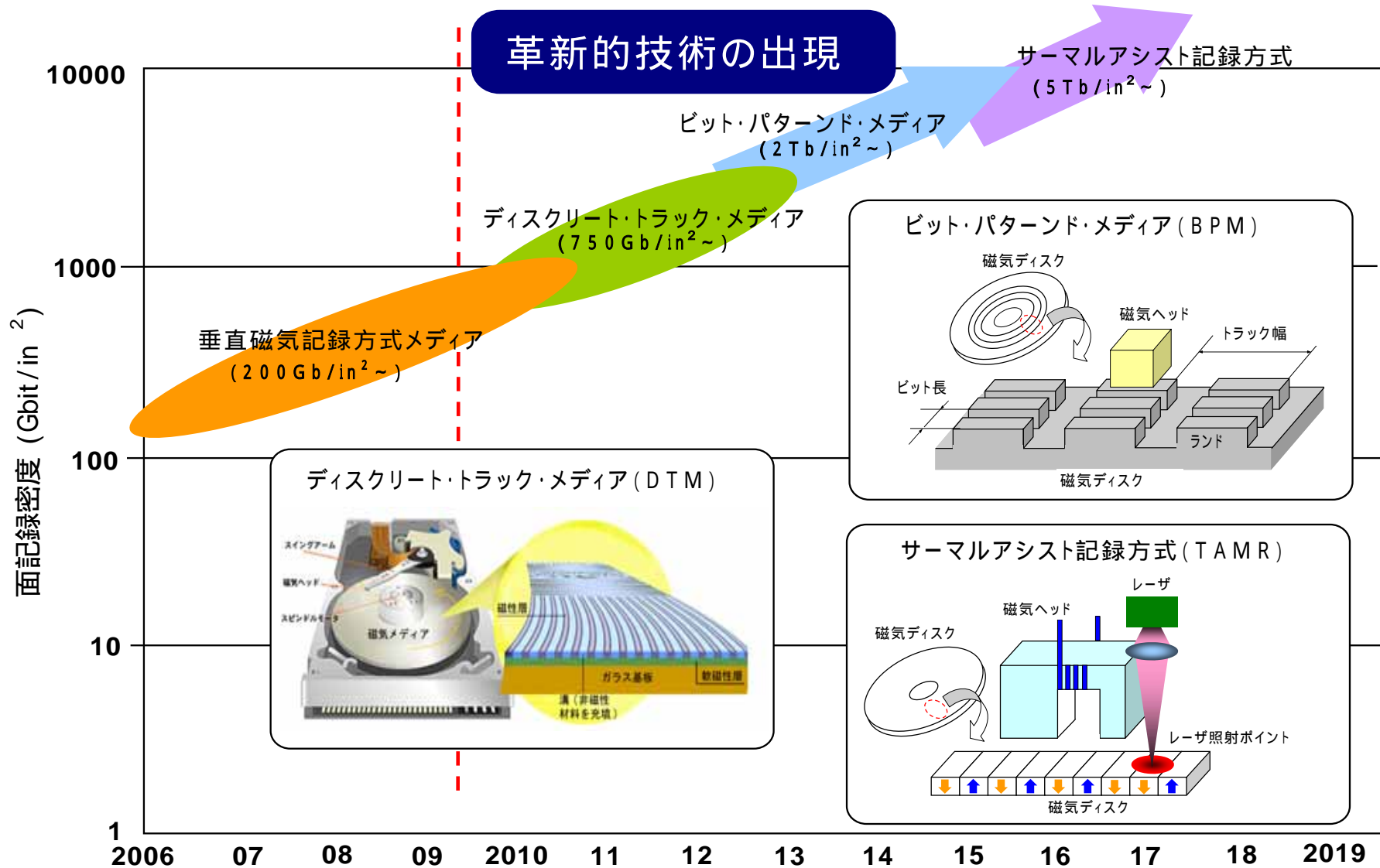
# セグメント別業績予想 (先端産業部材)

## 売上高の推移

## 前回予想比増減説明



# 【トピックス】HD関連技術ロードマップと技術革新



Data: IDEMA 資料

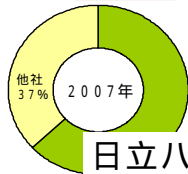
# 【トピックス】DTM関連装置の開発

## 更なるグローバルトップ製品の開発

### 現行製品群

#### サブストレート関連装置

<表面検査システム>



WW市場シェア

#### ヘッド関連装置

<ヘッドテスタ>

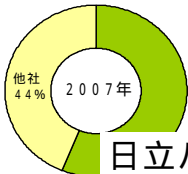


<クアジテスタ>



#### ディスク関連装置

<ディスクテストシステム>



WW市場シェア

<ディスク洗浄装置>



<テクスチャ装置>



### 新技術開発製品群

要求

ローコストナノ微細加工

技術

ナノインプリント技術

DTM製造・検査装置

ナノインプリント装置

要求

表面加工後の形状測定(溝)

技術

光検査技術

ナノパターン検査装置

要求

表面上の異物・突起検出

技術

光学検査技術

パーティクルモニタ

光学式ディスク検査装置

ディスク洗浄装置

エンハンス装置群の技術

・高感度光学検査技術

・洗浄クリーン技術

## 参考:データ集

(注)YY/MはYY年M月期を表しています。

# 四半期業績の推移

(億円)

	07年1Q	07年2Q	07年3Q	07年4Q	08年1Q	08年2Q
売上高	2,251	2,621	2,263	2,296	1,829	2,404
営業利益	87	146	81	178	19	106
経常利益	91	147	86	164	26	113
当期利益	57	90	55	67	2	78

## セグメント別売上高

(億円)

	07年1Q	07年2Q	07年3Q	07年4Q	08年1Q	08年2Q
電子デバイスシステム	635	766	587	661	250	612
ライフサイエンス	196	243	261	261	248	243
情報エレクトロニクス	546	700	543	539	443	616
先端産業部材	874	913	873	834	888	933



# 設備投資額・減価償却費・研究開発費

(億円)

	07 / 1H	08 / 1H	前年 同期比	08 / 3	09 / 3 (e1)	前年 同期比
設備投資額	47	57	+ 20%	113	149	+ 33%
減価償却費	42	43	+ 3%	89	99	+ 12%
研究開発費	101	106	+ 5%	204	224	+ 10%

(注) 設備投資額は取得ベースにて記載

## 前年同期比 増減説明 (08年度)

- 設備投資額: 37億円増加
  - ・那珂事業所増改築など
- 研究開発費: 20億円増加
  - ・電子デバイスシステム、ライフサイエンスの要素技術開発など

# 主要製品群別売上高の状況

(億円)

	07 / 1H	08 / 1H	前年 同期比	08 / 3	09 / 3(e1)	前年 同期比
<b>電子デバイスシステム</b>	1,400	863	38%	2,648	1,980	25%
プロセス装置	329	288	12%	748	528	29%
評価・解析装置	446	281	37%	902	746	17%
液晶関連製造装置	317	138	56%	500	420	16%
HD関連製造装置	97	31	68%	140	55	60%
その他	211	124	41%	358	231	35%
<b>ライフサイエンス</b>	440	491	+ 12%	962	970	+ 1%
バイオ・分析	107	93	13%	213	212	1%
メディカル	275	367	+ 33%	631	708	+ 12%
その他	58	32	45%	118	51	57%
<b>情報エレクトロニクス</b>	1,245	1,059	15%	2,327	2,200	5%
情報システム	512	459	10%	910	882	3%
組立装置	183	143	22%	334	331	1%
半導体	200	168	16%	394	367	7%
メディアデバイス	156	124	21%	313	248	21%
その他	194	164	15%	376	373	1%
<b>先端産業部材</b>	1,787	1,820	+ 2%	3,495	3,650	+ 4%
工業材料	899	900	+ 0%	1,714	1,791	+ 4%
電子デバイス材料	367	464	+ 26%	764	893	+ 17%
光関連部材	150	155	+ 3%	284	316	+ 11%
その他	371	302	19%	733	650	11%

(注) 08/1H, 09/3(e1)は会計方針変更後の数値です。

<資料取り扱い上の注意>

本プレゼンテーションで述べられている決算概要及び業績予想は、注記がある場合を除き、すべて連結です。

YY/M(e)はYY年M月期予想を表しています。

数値情報は、億円未満を四捨五入しています。

増減率は、基本的に円単位で計算しています。

本プレゼンテーションで述べられている将来の当社業績に関する予想は、現時点で知りうる情報をもとに策定されたものです。当社の参画する産業界はテクノロジーの変化が速く、競争の激しい産業です。また、世界経済、半導体市況、為替相場など、当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。したがって、今後、当社の業績が本プレゼンテーションと異なる可能性があることをお含みおください。但し、大きな変動がある場合は、証券取引所の適時開示規則及び当社の自発的判断等に基づき、その都度公表していく所存です。

また、この資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

END

---

2009年3月期第2四半期 決算説明会

お問合せ先

社長室 広報・IRグループ 部長代理 加藤 弘之

TEL:03-3504-5138 FAX:03-3504-5943

E-mail: kato-hiroyuki@nst.hitachi-hitec.com

**日立ハイテク**

最先端を、最前線へ。